

## 有机硅灌封/密封胶系列：

### 硅酮-加成固化

## HS 19127LV 低粘度导热灌封胶

### 描述：

HS 19127LV 是一种低粘度，阻燃，耐还原性有机硅化合物。低粘度和高导热性使 HS 19127LV 成为灌封要求散热的高密度组件封装的理想选择，该化合物具有出色的热稳定性和电性能，可与大多数电绝缘材料兼容，并具有 94 V-0 的 UL 94 阻燃等级。

### 未固化属性

	主剂	固化剂
颜色	灰色	自然白
粘度 (25°C, cps)	5000	3000
密度 (g/ml)	1.78	1.78
混合比例 (按重量或体积)	1 : 1	
混合粘度 (25°C, cps)	4000	
凝胶时间 (25°C、分钟)	30-60	
保质期 (25°C、月)	12	

## 固化后属性

硬度，肖氏硬度 A	50-60
拉伸强度 ( Mpa )	2.9
拉伸延展性 ( % )	120
热膨胀系数	$8.0 \times 10^{-5}$
导热系数 ( BTU-in/(ft <sup>2</sup> )(hr)(°F) )	5.2
工作温度 ( °C )	-55 至 204

## 电学性能

电介质常数 ( 绝缘强度，伏/密尔: )	500
介电常数，1KHZ	4.0
耗散因子，1KHZ	0.005
体积电阻率 ( ohm-cm )	$1.0 \times 10^{15}$

## 使用说明

1. 取出任何物质之前，将 HS 19127 LV 主剂和固化剂预先混合在原始容器中。  
会发生一些轻而柔和的沉淀，这些沉淀易于重新分散。
2. 确定主剂和固化剂的重量或体积相等的数量。
3. 彻底搅拌刮刮混合容器的底部和侧面。
4. 将混合物在-0.01Mpa 下抽真空 3-4 分钟以进行无空隙的铸件。
5. 倒入单元或模具中。

## 固化时间



—汉索—  
HANTHO

常州汉索电子材料科技有限公司

---

在室温下过夜 (在 25°C 下为 24 小时) 或在 60°C 下为 2 小时, 或在 95°C 30 分钟或在 120°C, 15 分钟。

## 储存要求

存放在室温下。该产品可能会在运输或存储时解决。使用前应将产品充分混合。

将物料存放在阴凉干燥的地方。